

実装フェスタ関西2024のご案内

【開催概要】



日時：2024年7月4日(木)～7月5日(金)

場所：パナソニックリゾート大阪

大阪府吹田市青葉丘南10-1 TEL 06-6877-0111

分野・競合を超えた技術者間の交流の場を重視。各業界における著名な先生方を講師にお招きし、実装関連技術の将来像を語って頂きます。

HP：<https://www.jiep.or.jp/event/workshop/jfk2024/index.php>

学生参加の優遇

人材育成と若手技術者交流の観点から多くの学生さんの参加を期待。学生参加費を従来以上に優遇（0円～）

スポンサーセッション

スポンサー企業の保有する技術や会社を紹介するセッションを開催。セッション参加学生には、特典【2日目の昼食クーポン進呈】を準備（上限あり）

プログラム

※下記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

基調講演 7月4日(木)

「IOWNを支える光電融合デバイスの進化」

塚野 英博 氏 (NTT)

招待講演 7月4日(木)

「EV、PHV向けパワー半導体に求められる技術要件を共に考える
～前工程からシステム出口までオールジャパンで半導体応用開発を加速させるために～」

山本 真義 氏 (名古屋大学)

「エレクトロニクス実装学会における光電融合に向けた取り組み」

那須 秀行 氏 (古河電気工業)

「車載・5G通信で培った部品・コンポーネントを搭載した
超小型人工衛星の宇宙空間での実証」

森 将人 氏 (パナソニック)

「低温焼成が可能な結晶制御された銅ナノ粒子濃厚分散系」

米澤 徹 氏 (北海道大学)

「部品内蔵基板EC2AM:
Embedded Copper Core Advanced Moduleの現状と今後の展開」

五十嵐 優助 氏 (エニマイクロジャパン)

「最近よく聞くESGって何のこと？～ややこしい英語・カタカナ使用禁止ver～」

津田 かおる 氏 (ノーリツ)

特別講演 7月4日(木)

「製造業の次の進化 (AIで激動する製造業がとるべきアクション)」

ものづくり太郎 氏 (ブーステック)

ナイトセッション 7月4日(木)

招待講演のテーマにて、各講師とグループディスカッション

特別対談 7月5日(金)

「分野間コミュニケーション CROSS POINT 2024 ～異分野の理解が技術の進化&深化を促す～」

基調講演 7月5日(金)

「半導体産業の持続的成長に向けて -今、何故「最先端半導体」を選択したか？-」 東 哲郎 氏 (Rapidus)

「人工知能、ロボット、そして人間」

ハルトノピトヨ 氏 (中京大学)

ポスターセッション 7月5日(金) 49件予定 第1部_午前 第2部_午後

ポスターセッション 49件を予定

第1部 7/5 (金) 9:15~10:45

第2部 7/5 (金) 14:15~15:45

第1部: 奇数番号
第2部: 偶数番号

発表者	所属	タイトル
サーマルマネージメント&パワーエレクトロニクス実装		
1 鈴木佑京	花王	高分散性を有する低温焼結銅微粒子
2 三好永哲	日本プラズマトリート	大気圧プラズマ技術Openair-Plasma(R)の電子機器・半導体・パワー半導体製品への展望
3 越智豊	ニホンハンダ	銅基板へ接合可能な無加圧高強度シンターペーストの開発
カーエレクトロニクス実装		
4 牧野由	日機装	3Dプレス技術を用いたシンタリング(焼結)装置紹介
三次元造形配線・実装応用技術		
5 野村康大	東レ	有機ハイブリッドボンディング用低温硬化性ポリイミドの開発
6 小山真司	群馬大学	金属塩の生成・分解反応を用いた各種金属材料の低温固相接合
7 本多敏行	東レリサーチセンター	TEMによるCu接合の詳細解析
プリンタブル・フレキシブルデバイス実装		
8 磯貝和生	東レ	半導体カーボンナノチューブを用いた塗布型半導体デバイスの開発
高速伝送実装		
9 清水昭宏	ウシオ電機	直接スパッタ銅シード層と無電解銅めっきシード層を用いた銅めっきシクロオレフィンポリマー上の伝送線路の高周波伝送特性の比較
10 山口貴史	荒川化学	半導体後工程向け低誘電材料を用いた高集積配線基板技術
11 谷脇美奈実	サンヨレック	UV硬化型低誘電樹脂の開発
材料技術		
12 中浜健太	大阪有機化学工業	ラジカル重合性低誘電液状プレポリマー材料の開発
13 渡邊大地	日本ビグメント	パワー半導体チップ実装に向けたダイボンディング銀焼結材料の開発
14 中川卓真	三菱マテリアル	ナノポーラスCuめっき構造を用いた直接接合技術の提案
15 武田光市	日本スペリア社	パワーエレクトロニクスに対応した焼結型接合材の開発
16 長島未希	メルテックス	アルミニウム電極上に厚膜形成可能な中性無電解銅めっき液
17 山本真矢 氏	中村超硬	半導体周辺樹脂材料への添加剤 ナノサイズゼオライト Zeoal
18 阿多誠介	産業技術総合研究所	第6世代移動通信システムに向けた低誘電・低損失な多孔質材料開発
信頼性解析技術		
19 長谷川将司	クオルテック	深層学習を利用したはんだクラック非破壊三次元解析
高速高周波・電磁特性技術		
20 三村憲一	産業技術総合研究所	次世代高速通信向け材料開発
配線板とその製造技術		
21 山本久尚	旭化成	高速通信積層板向け新規PPE樹脂の開発
22 上山浩幸	DTUS	MV-スパッタリングによるガラス基板への導体層形成技術について
23 米尚子	大和化成研究所	各種めっき液のノンシアン化に対する取り組み
24 深田和宏	芝浦機械	中真空スパッタで形成した銅シード層とシクロオレフィンポリマーフィルムの密着構造の分析
25 有本太郎	ウシオ電機	VUV処理技術の先端パッケージ向け配線への応用
26 妹尾駿作	パナソニック環境エンジニアリング	湿式工法を用いたガラス基板上へのCuめっき技術
27 石崎隼郎	ADEKA	Cu/Tiシードエッチング液の開発
電子部品・実装技術		
28 熊田祐朗 氏	三菱マテリアル	AuSn合金はんだ接合層の状態変化と信頼性について
29 縫田祐介	ADEKA	高熱伝導性樹脂材料のご紹介
30 岸本貴臣	田中貴金属工業	AgとSnを用いた液相拡散接合材料とその特性
31 上山椋平	三菱電機	素子/基板の固相拡散接合プロセスの簡易化
32 山崎浩次	群馬大学	硝酸塩被膜処理を施したCu板とSn-Znはんだの接合性評価
33 高木智也	奥野製薬工業	焼結基板の金属インク配線上へのパターン性に優れた無電解Ni-Bめっきプロセス
34 三好貴之	東レエンジニアリング	高精度と高生産性を両立させたD2Wハイブリッドボンダー
検査技術		
35 東昇	クラボウ	半導体ウエハ枚薬洗浄装置用In-Si-Tuプロセスモニタの開発
36 蝦名広大	島津テクノリサーチ	DIC解析の材料評価への活用
37 長谷川宏太郎	アドバンテスト	3D Packageにおける品質と信頼性の担保
システムインテグレーション実装技術		
38 福島誉史	東北大学	ハイブリッド接合によるDRAMチップ積層に向けたセルフアセンブリ技術の基礎検討
39 鈴木大地	アルバック	2周波ICPを用いたSmall TSV Etching技術の開発
40 五十井浩平	パナソニックホールディングス	低荷重接合を実現する先鋭マイクロバンプ接合技術
41 竹原造成	奈良・先端画像技術	誘電体多層膜RGBフィルタの耐放射線カメラへの応用
マイクロメカトロニクス実装技術		
42 大塚凌平	法政大学	黄色燐光マイクロ流体電気化学発光デバイスの開発
光回路実装技術		
43 吉田航	古河電気工業	FPGA搭載評価ステーションを用いたCPO向け超小型VCSELトランシーバの光リンク特性評価
環境調和型実装技術		
44 増田純也	日本スペリア社	Sn-Bi系鉛フリーはんだ合金の接合特性
その他		
45 後藤智久	ウシオ電機	円筒型太陽電池
46 鎌田龍太郎	東レ	先端半導体向けPFASフリーなモールド離型フィルムの開発
47 須貝幸司	エリコンジャパン	寿命を延ばす表面処理
48 原田知典	ウシオ電機	温室効果ガスN2O/CH4分解技術
49 高橋信行	レゾナック	フィルム型接着剤WelQuick: 簡便性と高機能性の両立

JFK2024 スポンサー

ウシオ電機(株)、サンヨレック(株)、奥野製薬工業(株)、オムロン(株)
(株)太洋工作所、東レエンジニアリング(株)、(株)日本スペリア社、ボンドテック(株)
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)、積水化学工業(株)、日本電子(株)
(株)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ、パナソニックコネク(株)